



推奨基板取付け寸法  
PC 基板厚: 1.6±0.1  
(非累積公差)  
(コネクタ搭載面)

RECOMEND PC BOARD HOLE PATTERN  
PC BOARD THICKNESS: 1.6±0.1  
(NOT ACCUMULATE TOLERANCE)  
(CONNECTOR MOUNT SIDE)

1. MATERIAL: HOUSING: GLASS FILED THERMO PLASTIC, POLYESTER COLOR: BLACK  
CONTACT: COPPER ALLOY  
RETENTION LEG: COPPER ALLOY
- △ FINISH (CONTACT AREA): 0.38 μm MIN GOLD PLATING OVER Ni PLATING
  - △ FINISH (CONTACT AREA): 0.76 μm MIN GOLD PLATING OVER Ni PLATING
  - △ FINISH (CONTACT AREA): 2.0 μm MIN TIN PLATED OVER NICKEL
  - △ FINISH (RETENTION LEG): TIN-LEAD PLATED (CONTACT TAIL) OVER NICKEL
  - △ FINISH (RETENTION LEG): TIN PLATED (CONTACT TAIL) OVER NICKEL
1. 材料: ハウジング: ガラス入り熱可塑性ポリエステル 色: 黒色  
コネクタ: 銅合金  
リテンションレグ: 銅合金
- △ めっき: コネクタ: 全面N下地 接触部: 0.38 μm MIN 全めっき
  - △ めっき: コネクタ: 全面N下地 接触部: 0.76 μm MIN 全めっき
  - △ めっき: コネクタ: 全面N下地 接触部: 2.0 μm MIN スズめっき
  - △ めっき: リテンションレグとコネクタ半田付部 —
  - △ めっき: リテンションレグとコネクタ半田付部 —
  - △ めっき: リテンションレグとコネクタ半田付部 —

△	△	178328-5
△	△	178328-3
△	△	178328-2
(FINISH)		製造番号 (PART NO.)

D REVISED (FJD0-0039-03) T S M 6/2/93		WIRE RANGE		INSULATION DIA		NAME	
C REVISED (FJD0-0114-03) T S M 7/4/93		mm(TAWG - )		mmφ		20POS DOUBLE ROW	
B REVISED (FJ00-0838-94) N M S M 7/4/94		MATERIAL		FINISH		VERTICAL HDR ASS'Y FOR DYNAMIC D-3100	
A REVISED (FJ00-0480-94) N M S M 4/22/94		SEE NOTE		SEE NOTE		SIZE LOC NUMBER	
O RELEASED (FJ88-0917-92) Y T S M 2/8/93		DR. 20-JAN-'93		DE. 20-JAN-'93		SCALE	
LTR		CHK. 8-FEB-'93		APP. 8-FEB-'93		REV. D SHEET 1 OF 1	
		S. MANABE		Y. TANAKA		C-178328	

(CUSTOMER DRAWING) 顧客用図面

NUMBER 178328  
METRIC  
PRINT DIST  
DIMENSIONS IN MILLIMETERS. DO NOT SCALE PRINT

AMP-J  
REV.10/93